

平成17年1月18日

報道各位

三井金属 米国における厚物電解銅箔の研究開発を強化

～05年3月より遊休設備を利用したプラント試験の実施と量産試作を開始～

当社 三井金属（社長 榎原 紘）は、米国ニューヨーク州における電解銅箔の研究開発拠点 Oak-Mitsui Technologies LLC（オークミツイ テクノロジーズ 以下 OMT 社）にて、2005年3月より厚物電解銅箔の研究開発および量産試作を開始いたします。遊休の電解設備を活用し効率的に開発・試作を行い、当該商品の性能向上を図ります。

既に同社では、設備再稼動に向け準備作業を開始しております。

<厚物電解銅箔の開発体制>

OMT 社は、当社銅箔事業の米国における研究開発拠点として、これまで次世代銅箔商品の研究開発を進めてまいりました。このたび、需要が伸びつつある厚物電解銅箔（厚さ105マイクロメートル以上）を新たに開発の対象とし、プラント試験および量産試作を行う体制を整え2005年3月から始動いたします。

試験設備は、研究専用のプラントとして、同社に隣接する休止中の電解銅箔の生産設備を活用いたします。これにより、プラント試験を実施し、開発の効率化および迅速化を図ります。

さらに、実際の設備で量産を想定した試作を行うことにより、将来の本格量産への円滑な移行が可能となります。

<投資額>

このたびの研究開発専用プラントとして遊休設備を再利用するにあたり、約900千USドルの投資を行います。

<商品の需要動向>

厚物電解銅箔は、通常、厚さ105マイクロメートル以上の電解銅箔を指し、主に、大型コンピュータ・通信インフラ・ハイブリッド自動車などに搭載する基板の配線材料に使用されます。これらの製品では、大型、高密度のICの動作や、自動車の電子制御のためにプリント基板の中を大電流が流れるため、抵抗値の低い厚物銅箔を使用し、回路の発熱を抑える必要があります。

現在、全世界の市場は、月に約140トン程度と見込まれ、内60%強を欧米が占めます。当社では、引き合い等の状況から判断し、今後も欧米を中心に需要が堅調に推移するものと見込んでおります。

<遊休設備および今後について>

今回、OMT社が利用する遊休設備は、かつて、Oak-Mitsui Inc.の汎用電解銅箔用(35マイクロメートルが中心)の生産ラインであり、2001年のITバブル崩壊時に休止(1)したものです。その後2003年、当社は、同敷地内にOMT社を設立し、米国における研究開発の拠点としてエンベディット・キャパシタ材料(2)などの新しい高機能商品の開発を行ってまいりました。

なお、今後OMT社で開発された厚物電解銅箔における商品や量産技術は、世界各地にある当社の電解銅箔生産拠点へ展開または活用を図っていく予定です。

1. ITバブル崩壊時に休止...記述のOak-Mitsui Inc.サウスカロライナ工場へ生産拠点を集約。

2. エンベディット・キャパシタ材料...当社の商品名: Farad Flex

プリント基板内部に埋め込むためのキャパシタ(コンデンサー)向け材料。当社開発の製品は、フィルム状樹脂材料(厚さ10~25μm)を銅箔(厚さ35μm)でサンドイッチ状にした構造の素材。基板のファインパターン化に伴い、次世代の潮流となりつつある電子部品内臓型基板への対応品として開発。

【ご参考】

- | | |
|--------|---|
| 1. 社名 | Oak-Mitsui Technologies LLC (オークミツイ テクノロジーズ) |
| 2. 所在地 | 米国 New York 州 Hoosick Falls (Oak-Mitsui Inc. 工場内) |
| 3. 代表者 | 桑子富士夫 |
| 4. 人員 | 人員 13 名 (2004 年 9 月末現在) |
| 5. 設立 | 2003 年 1 月 1 日 |

以上

【本件お問い合わせ先】

三井金属 経営企画部広報室 ^{ひじや} 泥谷・浅木 TEL 03-5437-8028 FAX 03-5437-8029
Eメール koho@mitsui-kinzoku.co.jp